

证券代码：301326

证券简称：捷邦科技

公告编号：2025-066

捷邦精密科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》。经过谨慎研究，公司决定继续实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”，并将“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2027年12月31日。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,810.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币51.72元/股，募集资金总额936,132,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币836,950,333.22元。募集资金已于2022年9月14日划至公司指定账户，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《捷邦精密科

技股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]41117号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目使用计划，截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金	截至2025年6月30日累计投入募集资金金额
1	高精密电子功能结构件生产基地建设项目	37,200.00	35,200.00	11,358.52
2	研发中心建设项目	9,800.00	9,800.00	-
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计		57,000.00	55,000.00	21,358.52

注：公司于2025年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，如审议通过，则“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”拟使用募集资金金额将调整为21,200.00万元。

三、募投项目历次调整情况

1、公司于2023年4月6日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。具体内容详见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-014）。

2、公司于2023年8月24日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据募集资金投资项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定暂缓实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”和“研发中心

建设项目”。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2023-035）。

3、公司于 2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定继续暂缓实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的公告》（公告编号：2024-086）。

四、重新论证并延期部分募集资金投资项目

（一）重新论证并延期的募投项目具体情况

截至 2025 年 6 月 30 日，“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”累计投入募集资金金额为 11,358.52 万元，投资进度为 32.27%，尚未使用的募集资金金额为 25,425.33 万元(含理财收益)，其中进行现金管理的募投资金金额为 24,200.00 万元。除用于现金管理外，剩余募集资金存放于募集资金专项账户中。

（二）重新论证并延期的具体原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”进行了重新论证，具体如下：

公司对“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”重新进行了研究和评估，认为目前全球消费电子行业有所复苏，AI 端侧应用的不断渗透推动了部分新兴智能硬件产品市场需求回暖，为产业链带来了新的机遇。基于整体市场需求变化、公司发展战略及公司现阶段的实际经营情况，为更好的应对市场变化和抓住增长机遇，公司拟继续实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”，并将“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 12 月 31 日。

公司将持续关注外部环境变化，对募集资金投资项目的实施进行合理安排，确保项目推进能够符合市场变化以及公司战略规划，实现公司利益最大化。

五、对公司经营的影响

本次对“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”的重新论证并继续实施，是公司根据项目实际情况及公司自身战略等因素做出的审慎决定，不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投资用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》。董事会认为：公司重新论证并继续实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”是综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要作出的审慎决定，有利于扩充公司产能，进一步增强公司核心竞争力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，董事会同意继续实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”，并将“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2027年12月31日。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期事项是根据外部环境变化及募投项目的实际建设情况而作出的调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，监事会同意本次“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”重新论证继续实施并延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期事项已经第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，履行了必要的程序。公司本次“高精密电子功能结构件生产基地建设项

目”重新论证继续实施并延期事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。

综上所述，保荐机构对本次“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”重新论证继续实施并延期事项无异议。

七、备查文件

- （一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- （二）捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
- （三）中信建投证券股份有限公司出具的《关于捷邦精密科技股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的核查意见》。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日